



中华人民共和国国家标准

GB/T 35010.7—2018/IEC/TR 62258-7:2007

半导体芯片产品 第7部分:数据交换的XML格式

Semiconductor die products—Part 7:XML schema for data exchange

(IEC/TR 62258-7:2007, IDT)

2018-03-15 发布

2018-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总则	1
5 数据交换	2
附录 A (规范性附录) XML 格式	3
附录 B (资料性附录) XML 实例	19

前 言

GB/T 35010《半导体芯片产品》分为以下部分：

- 第 1 部分：采购和使用要求；
- 第 2 部分：数据交换格式；
- 第 3 部分：操作、包装和储存指南；
- 第 4 部分：芯片使用者和供应商信息表；
- 第 5 部分：电学仿真要求；
- 第 6 部分：热仿真要求；
- 第 7 部分：数据交换的 XML 格式；
- 第 8 部分：数据交换的 EXPRESS 格式。

本部分为 GB/T 35010 的第 7 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分使用翻译法等同采用 IEC/TR 62258-7:2007《半导体芯片产品 第 7 部分：数据交换的 XML 格式》。

与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

- GB/T 2900（所有部分） 电工术语 [IEC 60050（所有部分）]
- GB/T 35010.1—2018 半导体芯片产品 第 1 部分：采购和使用(IEC 62258-1:2009, IDT)
- GB/T 35010.2—2018 半导体芯片产品 第 2 部分：数据交换格式(IEC 62258-2:2011, IDT)
- GB/T 35010.4—2018 半导体芯片产品 第 4 部分：芯片使用者和供应商要求(IEC/TR 62258-4:2012, IDT)
- GB/T 35010.5—2018 半导体芯片产品 第 5 部分：电学仿真要求(IEC 62258-5:2006, IDT)
- GB/T 35010.6—2018 半导体芯片产品 第 6 部分：热仿真要求(IEC 62258-6:2006, IDT)

本部分做了下列编辑性修改：

- 删除了 IEC/TR 62258-7:2007 中第 5 章的第 3 段关于 IEC/TR 62258-7:2007 电子文本的获取方法以及使用要求的内容；
- 删除了参考文献。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC 78)归口。

本部分起草单位：中国电子科技集团第 58 研究所、北京大学、清华大学、哈尔滨工业大学、中微爱芯电子有限公司。

本部分主要起草人：章慧彬、陆坚、赵桦、王菲、王亚婷、王自强、张威、陈洋

半导体芯片产品

第 7 部分:数据交换的 XML 格式

1 范围

GB/T 35010 的本部分用于指导半导体芯片产品的生产、供应和使用。其中半导体芯片产品包括:

- 晶圆;
- 单个裸芯片;
- 带有互连结构的芯片与晶圆;
- 最小或部分封装的芯片与晶圆。

本部分规定了一种 XML 格式,该格式定义了数据交换所需的元素,满足 IEC 62258-1、IEC 62258-5、IEC 62258-6 的实施要求,同时对 IEC 62258-2 中定义的交流结构进行补充。本部分也补充并兼容 IEC/TR 62258-4 中的调查表。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC 60050 (所有部分) 电工词汇(International Electrotechnical Vocabulary)

IEC 62258-1 半导体芯片产品 第 1 部分:采购和使用要求(Semiconductor die products—Part 1: Requirements for procurement and use)

IEC 62258-2 半导体芯片产品 第 2 部分:数据交换格式(Semiconductor die products—Part 2: Exchange data formats)

IEC/TR 62258-4 半导体芯片产品 第 4 部分:芯片使用者和供应商要求(Semiconductor die products—Part 4: Questionnaire for die users and suppliers)

IEC 62258-5 半导体芯片产品 第 5 部分:电学仿真要求(Semiconductor die products—Part 5: Requirements for information concerning electrical simulation)

IEC 62258-6 半导体芯片产品 第 6 部分:热仿真要求(Semiconductor die products—Part 6: Requirements for information concerning thermal simulation)

3 术语和定义

IEC 60050(所有部分)和 IEC 62258-1 界定的术语和定义适用于本文件。

4 总则

本部分中的格式与可扩展标记语言(XML)一致。

本部分要求芯片器件供应商向使用者提供芯片器件在设计、采购、制造和测试各阶段的必要且充分的信息。附录 A 中的格式定义了一种交换机制,该交换机制为 XML 语言的陈述而构建信息,这也是为了达到遵行本部分的目的。